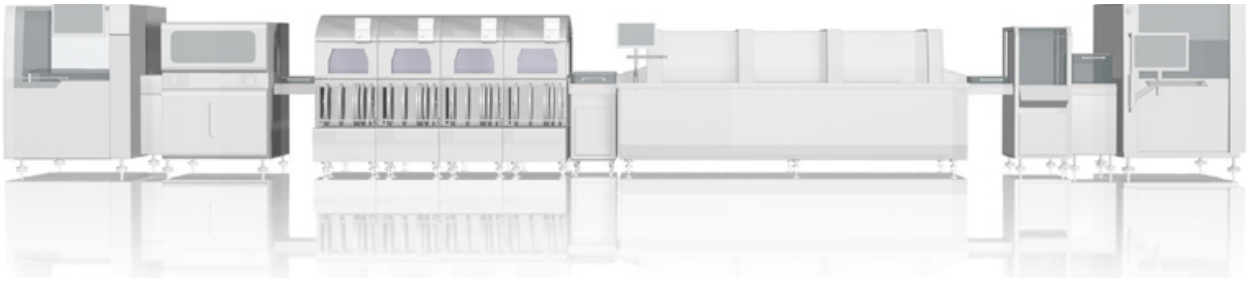
BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste



Bestückungslinie 1

Siebdruck

ASMPT DEK TQ-L

Baujahr	2025
Max. Druckformat / Platinengröße	600 x 510 mm
Nassdruckgenauigkeit	17 µm
Zykluszeit	6,5 sek
Transportsystem	dreistufiger Transport für schnellen Zyklus
Unterstützungssystem	• Smart-Pin-Support, 60 Unterstützungspins • Grid-Lock
Spezielle Funktionen	• Automatischer Lotpastendispenser • Lotpastenhöhenkontrolle • Schablonen Autoload • VectorGuard High Tension Spannrahmen

Dispensen

Mycronic in-line dispenser MYSMART MYD10I

Baujahr	2023
Max. Platinengröße	475 mm Breite
Min. Platinengröße	50 mm Breite
Dispensfläche	440 x 760 mm
Genauigkeit	XY: ±30 µm @ 3σ Z: ±10 µm @ 3σ
Geschwindigkeit	1,000 mm/s (X, Y)
Sonstiges	• Jetventil zum Dispensen von Kleber • Schraubventil zum Dispensen von Lotpaste

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Prüfen

Saki SPI 3Si-LS2

Baujahr	12/2019
Max. Platinengröße	460 x 510 mm
Bauteilfreiheit oberhalb	x mm
Bauteilfreiheit unterhalb	x mm
Kleinste Bauteilgröße	01005 / pitch 0,25 mm
Kameramodul	CMOS Area Camera
Bildaufnahmetechnologie	digitale 2-Wege Projektion
Optik	telezentrische Kameratechnologie
Auflösung	18 µm in X/Y-Richtung 0,33 µm in Z-Richtung
Beleuchtung	multidirektionales Ringlicht
Bildaufnahmezeit	390 ms/FOV
Zusätzliche Informationen	• Wiederholbarkeit 2 µm bei 3 Sigma • Messbare Bauteilrotation: 0-359° Rotation (1°-Schritte) • Inspektionskategorien Höhe, Volumen, Fläche, Brücke, Versatz, Form

Bestückungsautomat

3x ASM Siplace SX1/2

Baujahr	2x 09/2018 1x 07/2022
Bestückleistung	IPC 50.000 Bauteile/h
effektive Bestückleistung	30.000 Bauteile/h
Feederkapazität (8mm)	330 Stück
Max. Platinengröße	450 x 560 mm
Min. Platinengröße	50 x 50 mm
Min. Auflagerand für Transportsystem	3 mm
Sonstiges	• CPP-Bestückköpfe • Twin Star Bestückungskopf mit einer Aufsetzkraft von 70Nm (für Pin-in-Paste-Bauelemente mit Snap-in-Anschlüssen) • Alle Bestückungsköpfe sind mit einer hochauflösenden Kamera, Vakuumsensor, Kraftmessung, Bauelementesensor, integrierter Drehstation pro Segment, Kontrolle der LP-Wölbung und Einzelaufnahme pro Bauelement ausgestattet. • Frei programmierbare automatische Leiterplattenunterstützung • Optimierte Rüstung über Wechseltische • Pin-1-Erkennung während der Bestückung möglich • Face-Down-Erkennung der Bauelemente

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Löten

Rehm Reflow-Lötsystem VXP Nitro 3500 Typ734

Baujahr	2025
Max. Platinengröße	508 mm Breite
Min. Platinengröße	55 mm Breite
Freiraum über Transport	30 mm
Transportgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar von 180 bis 1.800 mm/min
Min. Auflagerand für Transportsystem	beidseitig 5 mm
Vorheizzonen	7 Stück
Peakzonen	3 Stück
Kühlzonen	4 Stück
Durchsatz	145 Stück/Std. (Näherungswerte bei einer BG-Länge von 300 mm und einem Abstand von 100 mm)
Sonstiges	• Mittenunterstützung Arbeitsbereich 65 mm zur festen Wange • Leiterplattendurchlaufüberwachung • Sickstoffregelung • Prozessgasreinigung durch Pyrolyse • Lüfter/ Temperaturüberwachung • Kic X5 Datenlogger mit 7 Kanälen

Bestückungslinie 2

Siebdruck

ASMPT DEK TQ-L

Baujahr	2025
Max. Druckformat / Platinengröße	600 x 510 mm
Nassdruckgenauigkeit	17 µm
Zykluszeit	6,5 sek
Transportsystem	dreisstufiger Transport für schnellen Zyklus
Unterstützungssystem	• Smart-Pin-Support, 60 Unterstützungspins • Grid-Lock
Spezielle Funktionen	• Automatischer Lotpastendispenser • Lotpastenhöhenkontrolle • Schablonen Autoload • VectorGuard High Tension Spannrahmen

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Prüfen

Saki SPI 3Si-LS2

Baujahr	12/2025
Max. Platinengröße	460 x 510 mm
Bauteilfreiheit oberhalb	x mm
Bauteilfreiheit unterhalb	x mm
Kleinste Bauteilgröße	01005 / pitch 0,25 mm
Kameramodul	CMOS Area Camera
Bildaufnahmetechnologie	digitale 2-Wege Projektion
Optik	telezentrische Kameratechnologie
Auflösung	18 µm in X/Y-Richtung 0,33 µm in Z-Richtung
Beleuchtung	multidirektionales Ringlicht
Bildaufnahmezeit	390 ms/FOV
Zusätzliche Informationen	• Wiederholbarkeit 2 µm bei 3 Sigma • Messbare Bauteilrotation: 0-359° Rotation (1°-Schritte) • Inspektionskategorien Höhe, Volumen, Fläche, Brücke, Versatz, Form

Bestückungsautomat

2x ASM Siplace SX1/2

Baujahr	2x 2025
Bestückleistung	IPC 50.000 Bauteile/h
effektive Bestückleistung	20.000 Bauteile/h
Feederkapazität (8mm)	210 Stück
Max. Platinengröße	450 x 560 mm
Min. Platinengröße	50 x 50 mm
Min. Auflagerand für Transportsystem	3 mm
Sonstiges	• CPP-Bestückköpfe • Twin Star Bestückungskopf mit einer Aufsetzkraft von 30Nm (für Pin-in-Paste-Bauelemente mit Snap-in-Anschlüssen) • Alle Bestückungsköpfe sind mit einer hochauflösenden Kamera, Vakuumsensor, Kraftmessung, Bauelementesensor, integrierter Drehstation pro Segment, Kontrolle der LP-Wölbung und Einzelaufnahme pro Bauelement ausgestattet. • Frei programmierbare automatische Leiterplattenunterstützung • Optimierte Rüstung über Wechseltische • Pin-1-Erkennung während der Bestückung möglich • Face-Down-Erkennung der Bauelemente

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Löten

Rehm Reflow-Lötsystem VisionXS nitro 3150

Baujahr	2015
Max. Platinengröße	460 mm Breite
Min. Platinengröße	50 mm Breite
Freiraum über Transport	30 mm
Transportgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar von 180 bis 1.800 mm/min
Min. Auflagerand für Transportsystem	beidseitig 5 mm
Vorheizzonen	6 Stück mit insgesamt 2.100 mm Länge
Peakzonen	3 Stück mit insgesamt 1.050 mm Länge
Kühlzonen	4 Stück mit insgesamt 1.400 mm Länge
Durchsatz	130/Std. (Näherungswerte bei einer BG-Länge von 300 mm und einem Abstand von 100 mm)
Sonstiges	• Durchgängige Ober- und Unterheizung • Stickstoffregelung • KIC X5 Datenlogger mit 7 Kanälen

Linien unabhängige Maschinen und Geräte

Prüfen

Saki AOI 3Di-LS2

Baujahr	10/2019
Max. Platinengröße	500 x 510 mm
Bauteilfreiheit oberhalb	40 mm
Bauteilfreiheit unterhalb	60 mm
Kleinste Bauteilgröße	01005 / pitch 0,25 mm
Kameramodul	CMOS Area Camera
Bildaufnahmetechnologie	digitale 4-Wege Projektion
Optik	telezentrische Kameratechnologie
Auflösung	18 µm in X/Y-Richtung 1 µm in Z-Richtung
Beleuchtung	multidirektionales Ringlicht
Bilderfassungszeit	5.700 mm²/s
Zusätzliche Informationen	• Leiterplattendicke 0,6 bis 5,2 mm • Leiterplattenverbiegung +/- 2 mm

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Lebert EFA Smart View

Baujahr	10/2026
Vorlagengröße	460 x 460 mm
Beleuchtung:	Power LED Beleuchtung von oben und seitlich inkl. Linearpolarisationsfiltern
Automatische Inspektion mit Erkennung von:	• fehlenden Bauteilen • Polaritäten der Bauteile • Bauteilebeschriftung (OCR)

Comet Yxlon Röntgensystem Cheeta EVO

Baujahr	05/2025
Max. Prüfteilgröße (Ø x H)	800 x 500 mm
Max. Prüfbereich 2D (B x H)	460 x 410 mm
Röntgenquelle	**FXT-160.50**
Röhrentyp	Mikrofokus, offen
Max. Leistung	64 W
Max. Targetleistung	15 W
Ortsauflösung	2,0 µm
Detektor	**1515**
Aktiver Bereich	152 x 152 mm
Pixelmatrix	1.256 x 1.256
Pixelabstand	119 µm
Max. Bildfrequenz	60 Hz

Dr. Eschke Modularer Kombinationstester CT300 Meteor

Baujahr	2006
ICT-Testpunkte	max. 1.728 (14 Slots)
Funktionstest	1 GS/s analog 300 MS/s digital
Paralleltests	> 2.500 Teile/s
Testumfang	• Entladungstest • Kontaktierungstest • Kurzschlusstest • In-Circuit-Test (ICT) • Kondensator-Polaritätstest • Pin-Scan-Test • Funktionstest
Sonstiges	Einbindung einer Programmierumgebung möglich

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Reinigen

Kolb Schablonen Reinigungssystem PSE 300HD

Baujahr	2022
Prozesskammermaße	350 x 980 x 920 mm
Temperaturlast	bis zu 50° C
Regelbereich Trocknung	ca. 40 - 45° C
Sonstiges	• Sieb/Schablonenreinigung • Carrier / Waschrahmen bis 950 x 780 mm • Reinigung von Misprints

IMO Platinen Reinigungssystem ÖKO 2000

Baujahr	2023
Prozesskammermaße	500 x 530 x 500 mm
Reinigungskapazität pro Prozess	170 Eurokarten
Temparaturlast	bis zu 70° C
Regelbereich Trocknung	50 - 100° C
Sonstiges	• Heißlufttrocknung • automatische Dosierung vom Reinigungsmedium • individuelle Reinigungsprogramme • Überwachung des Reinheitsgrades des Spülwassers

THT - Löten

ERSA Selektivlötanlage Versaflow 4/55

Baujahr	05/2018
Lotart	bleifrei
Max. Platinengröße	460 x 460 mm
Min. Platinengröße	50 x 50 mm
Atmosphäre	Stickstoff
Tiegelanzahl	2
Sonstiges	• Bearbeitung einer Baugruppe mit unterschiedlichen Lötdüsen • Parallele Bearbeitung mit beiden Löttigeln • Micro Drop Fluxer für den punktgenauen Einsatz von Flussmittel • VERSACAM für Lötwellenhöhenmessung „on the fly” • VERSAFLEX Lötmodul x/y/z-variabel • Powerkonvektion für optimale homogene Durchwärmung • Paralleler Prozess durch Trennung von Fluxen, Vorheizen und Löten

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Laser

ASYS Insignum 4000 Laser

Baujahr	05/2018
Max. Platinengröße	508 x 508 mm
Min. Platinengröße	70 x 50 mm
Laserquelle	CO_2-Laser
Markierinhalte	Barcode, DataMatrix-Code, Texte oder Logos
Kleinste Modulgröße	kleiner 5 mm
Sonstiges	• Integrierte Wendestation • Automatische Be-/Entladung • Passermarken Erkennung • Code Kontrolle mit integrierter Kamera

Trocknen

Thermo Fisher Scientific Heratherm™ Trockenschrank

Baujahr	05/2014
Temperaturbereich	50 - 330° C
Kammer	Edelstahl 1.4301
Kammergröße	464 x 708 x 518 mm
Maximale Traglast Einlegeboden	25 kg
Zeitschaltuhr Funktionen	wahlweise wöchentlich / stündlich / Echtzeit
Frischluftklappe	elektronisch gesteuert

Dispensen (Gehäuse)

Vieweg Robotersystem VR3203

Baujahr	2019
Arbeitsbereich X-Achse	200 mm
Arbeitsbereich Y-Achse	200 mm
Arbeitsbereich Z-Achse	50 mm (R-Achse ± 360°)
Geschwindigkeit PTP (X,Y)	X-Achse 700 mm/s; Y-Achse 750 mm/s;
Geschwindigkeit PTP (Z)	Z-Achse 250 mm/s; R-Achse 900 °/s
Geschwindigkeit CP (X, Y, Z)	600 mm/s Kombination von X-/Y-/Z-Bewegungen
Wiederholgenauigkeit	± 0,008 mm pro Achse, (R ± 0,01 mm pro Achse; R-Achse ± 0,008 °)
Traglast Tisch	7 kg
Traglast Werkzeug	3,5 kg

BRAUN Industrieelektronik GmbH
Uhlmannstraße 45
88471 Laupheim

+49 (0) 7392/96 98-0
info@braun-gmbh.com
www.braun-gmbh.com

Maschinenliste

Einschweißen

Air Zero Vakuumiergerät AZ-450-E-D

Baujahr	10/2014
Maximale Länge der Schweißnaht	450 mm
Breite der Schweißnaht	5,10 mm
Sonstiges	• Rückbegasungseinrichtung für Stickstoff

Reines Arbeiten

Asys Lamino Workplace L-6-12-T

Baujahr	02/2015
Strömungsart	Laminare Strömung
Reinheitsklasse	ISO 5 nach DIN ISO 14644-1
Vorfilter	Filterklasse G4
Feinfilter	Schwebstofffilter Klasse H14
Gebläse	Hochleistungs-ES-Radialventilator
Luftstrom	1.160 m³/h
Arbeitsraumabgrenzung	4-seitig vorhanden, Bedienseite: 150 mm

Lagern

Mimot Manufacturing Logistics Terminal (MLT)

Baujahr	12/2016
Kapazität	4.700 SMD Rollen
Rollengröße	8 mm/7“ - 56 mm/15“
Sonstiges	Um jederzeit einen schnellen Zugriff auf das Material zu gewährleisten, ist das System mit getrennten Ein-/Ausgabestationen ausgestattet.

Tech Valley Bauteilzähler HAWKEYE2000

Baujahr	2025
Scanplätze	4 Stück
Scanzeit	10 sek
Bauteilspektrum	008004 bis hin zu großen Stecker
Scanbare Gebinde	• Bauteilrollen • Trays • spezielle Formen • Dry-Packs • Stangen • Gurtabschnitte